



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092020-221592
CG-DL-E-07092020-221592

**असाधारण
EXTRAORDINARY**

**भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1**

**प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 232]
No. 232]

नई दिल्ली, सोमवार, सितंबर 7, 2020/भाद्र 16, 1942
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2020/BHADRA 16, 1942

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(आई.पी.एच.डब्ल्यू)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितंबर, 2020

विषय: सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 के अनुक्रम में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को अधिसूचित करना

संदर्भ: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के दिनांक 28.05.2018, 29.05.2019 और 04.06.2020 के आदेशों के जरिए यथासंशोधित आदेश संख्या पी-45021/2/2017-बीई-II दिनांक 15.06.2017

फा. सं. डब्ल्यू-43/4/2019-आईपीएचडब्ल्यू-एमईआईटीवाई.—सरकार ने 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने और आय और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के दिनांक 28.05.2018, 29.05.2019 और 04.06.2020 के आदेशों के जरिए यथासंशोधित आदेश संख्या पी-45021/2/2017-बीई-II, दिनांक 15.06.2017 के तहत सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 जारी किया है।

2. उपर्युक्त संदर्भ के जरिए अधिसूचित सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 [पीपीपी-एमआईआई आदेश 2017] के अनुक्रम में और इसके तहत जारी की गई दिनांक 14.09.2017 की इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अधिसूचना संख्या 33(1)/2017-आईपीएचडब्ल्यू और दिनांक 01.08.2018 की अधिसूचना संख्या 33(5)/2017-आईपीएचडब्ल्यू के अधिक्रमण में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) एतद्वारा अधिसूचित करता है कि समय-समय पर संशोधित पूर्वोक्त आदेश के अनुसार स्थानीय रूप से विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को सभी क्रय संस्थाओं द्वारा वरीयता प्रदान की जाएगी।

3. इस अधिसूचना के उद्देश्य से:

- क. श्रेणी-। स्थानीय आपूर्तिकर्ता, श्रेणी-॥ स्थानीय आपूर्तिकर्ता और गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता की परिभाषा समय-समय पर यथासंशोधित डीपीआईआईटी पीपीपी-एमआईआई आदेश, 2017 संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बीई-॥), दिनांक 04.06.2020 के पैरा 2 के अनुसार होगी। समय-समय पर यथासंशोधित डीपीआईआईटी पीपीपी-एमआईआई आदेश, 2017 संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बीई-॥), दिनांक 04.06.2020 के पैरा 5 के अनुसार इस अधिसूचना में अधिसूचित प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के लिए स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र निर्धारित किया गया है।
- ख. समय-समय पर यथासंशोधित डीपीआईआईटी पीपीपी-एमआईआई आदेश, 2017 संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बीई-॥), दिनांक 04.06.2020 के पैरा 3क क्रय के प्रतिशत के लिए संदर्भित किया जाएगा जिसके लिए अधिमानतः घरेलू स्तर पर विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों (मूल्य के संदर्भ में) को वरियता दी जानी है।

4. सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 के तहत निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अधिसूचित किए गए हैं:

4.1 डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर (पीसी)

(क) परिभाषा:

इस अधिसूचना के प्रयोजन से एक डेस्कटॉप पीसी में आवश्यक रूप से एक सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, की-बोर्ड, माउस और एक अलग या एकीकृत डिस्प्ले यूनिट शामिल होगी और इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षर्थ होना चाहिए।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्रः

डेस्कटॉप पीसी की सामग्री का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बी.ओ.एम के प्रमुख इनपुट/डेस्कटॉप पीसी के विनिर्माण के लिए चरण	घरेलू बीओएम के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले इनपुट के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन/स्थानीय सामग्री
1	2
मुख्य बोर्ड/मदरबोर्ड और सीपीयू/जीपीयू	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण, जिसमें सेमीकंडक्टर्स** और सीपीयू/जीपीयू** का मूल्य शामिल है और बेयर पीसीबी का मूल्य इसमें शामिल नहीं है। हालाँकि, सीपीयू के कुल मूल्य का भार डेस्कटॉप पीसी के कुल बीओएम के 30% से अधिक नहीं होगा।
मेमोरी मॉड्यूल	बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर, आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित बेयर पीसीबी पर आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित मेमोरी चिप्स** और कलपुर्जों से घरेलू पीसीबी असेंबली* एवं परीक्षण।
हार्ड डिस्क ड्राइव/सॉलिड स्टेट ड्राइव (एसएसडी)	बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* एवं फाइनल उत्पाद असेम्बली और परीक्षण।
एलसीडी/एलईडी मॉनिटर	आयातित/घरेलू रूप से असेम्बल किए गए एलसीडी/एलईडी पैनल वाले कलपुर्जों से एलसीडी/एलईडी मॉनिटर की घरेलू स्तर पर असेम्बली और परीक्षण और घरेलू पीसीबी असेंबली*, घरेलू प्लास्टिक मोल्डिंग और बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर धातुरुई कलपुर्जों की स्टैम्पिंग।

डीवीडी ड्राइव	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू असेबली और परीक्षण।
कैबिनेट + एमएमपीएस	घरेलू रूप से विनिर्मित कैबिनेट और घरेलू पीसीबी असेबली* और आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से एसएमपीएस की फाइनल असेबली और परीक्षण, इस शर्त के अध्यधीन कि "एसएमपीएस" की असेबली में उपयोग किए जाने वाले घरेलू विनिर्मित कलपुर्जों और संघटक न्यूनतम 20% होंगे ("एसएमपीएस" के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले कलपुर्जों और संघटकों के कुल मूल्य के)।
की-बोर्ड और माउस	घरेलू पीसीबी असेबली* और आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से फाइनल असेबली और परीक्षण।
बेयर पीसीबी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू रूप से विनिर्मित।
(i) फाइनल असेबली/परीक्षण और (ii) डिजाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेबल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

*यह आवश्यक है कि एसएमटी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए बेयर पीसीबी पर सीपीयू (एस)/जीपीयू/प्रोसेसर (एस) कलपुर्जों/संघटकों के प्रिटेड सर्किट बोर्ड की असेबली (पीसीबीए) अनिवार्य रूप से भारत में की जानी चाहिए।

**भारत में सेमीकंडक्टर फैब चालू होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

4.2 थिन क्लाइंट

(क) परिभाषा:

इस अधिसूचना के प्रयोजन से किसी थिन क्लाइंट (टीसी) में अनिवार्य रूप से सीपीयू, मेमोरी, डोम, की-बोर्ड, माउस और एक अलग या एकीकृत डिस्प्ले यूनिट शामिल होते हैं और यह स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्रः

थिन क्लाइंट की सामग्री का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम के प्रमुख इनपुट/थिन क्लाइंट के विनिर्माण के लिए चरण	घरेलू बीओएम के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले इनपुट के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन/स्थानीय सामग्री
1	2
मुख्य बोर्ड/मदरबोर्ड और सीपीयू	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेबली* और परीक्षण, जिसमें सेमीकंडक्टर्स** और सीपीयू** का मूल्य शामिल है और बेयर पीसीबी का मूल्य इसमें शामिल नहीं है। हालाँकि, सीपीयू के कुल मूल्य का भार थिन क्लाइंट के कुल बीओएम के 30% से अधिक नहीं होगा।

मेमोरी मॉड्यूल/डोम	बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित बेयर पीसीबी पर आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित मेमोरी चिप्स** और कलपुर्जों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण।
एसएमपीएस/पावर अडेप्टर	घरेलू रूप से पीसीबी असेंबली* और आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से एसएमपीएस / पावर अडेप्टर की फाइल असेंबली और टेस्टिंग, इस शर्त के अधीन है कि "एसएमपीएस" की असेंबली में प्रयुक्त घरेलू विनिर्मित पुर्जे और कलपुर्जे न्यूनतम 20% होंगे ("एसएमपीएस") के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले कलपुर्जों और संघटकों के कुल मूल्य के)।
एलसीडी/एलईडी मॉनिटर	आयातित/घरेलू रूप से असेंबली किए गए एलसीडी/एलईडी पैनल वाले कलपुर्जों से एलसीडी/एलईडी मॉनिटर की घरेलू स्तर पर असेंबली और परीक्षण और घरेलू पीसीबी असेंबली*, घरेलू प्लास्टिक मोल्डिंग और बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर धातुर्द कलपुर्जों की स्टैम्पिंग।
कैबिनेट	घरेलू तौर पर विनिर्मित।
की-बोर्ड और माउस	घरेलू पीसीबी असेंबली* और आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से फाइल असेंबली और परीक्षण।
बेयर पीसीबी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू रूप से विनिर्मित।
(i) फाइल असेंबली / परीक्षण और (ii) डिजाइन / विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेंबली/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

*यह आवश्यक है कि एसएमटी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए बेयर पीसीबी पर सीपीयू (एस)/जीपीयू/प्रोसेसर (एस) कलपुर्जों/संघटकों के प्रिटेड सर्किट बोर्ड की असेंबली (पीसीबीए) अनिवार्य रूप से भारत में की जानी चाहिए।

**भारत में सेमीकंडक्टर फैब चालू होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

4.3 लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर (पीसी)

(क) परिभाषा :

इस अधिसूचना के प्रयोजन से किसी लैपटॉप पीसी (जिसे आमतौर पर लैपटॉप/नोटबुक/नेटबुक/अल्ट्राबुक आदि के रूप में बाजार में जाना जाता है) में आवश्यक रूप से सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, टचपैड और/या ट्रैकपॉइंट एकीकृत प्रदर्शन इकाई, एकीकृत बैटरी शामिल होंगे और यह स्वतंत्र रूप से प्रचालित होने में सक्षम होना चाहिए।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र:

लैपटॉप पीसी का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट व्यक्तिगत रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम प्रमुख इनपुट लैपटॉप के विनिर्माण के लिए चरण	घरेलू बीओएम के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले इनपुट के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन/ स्थानीय सामग्री
1	2
मुख्य बोर्ड/मदरबोर्ड और सीपीयू/जीपीयू	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण, जिसमें सेमीकंडक्टर्स** और सीपीयू/जीपीयू** का मूल्य शामिल है और बेयर पीसीबी का मूल्य इसमें शामिल नहीं है। हालाँकि, सीपीयू के कुल मूल्य का भार लैपटॉप के कुल बीओएम के 35% से अधिक नहीं हो।
पावर मॉड्यूल	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण।
मेमोरी मॉड्यूल	बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर, आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित बेयर पीसीबी पर आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित मेमोरी चिप्स** और कलपुर्जों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण।
हार्ड डिस्क ड्राइव/सॉलिड स्टेट ड्राइव (एसएसडी)	बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर, आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और फाइनल उत्पाद असेम्बली और परीक्षण।
डिस्प्ले पैनल (एलसीडी, एलईडी, आदि)	बैक कवर और बेजेल में घरेलू असेंबली और बैक कवर और बेजेल के मूल्य को छोड़कर, आयातित/घरेलू स्तर पर डिस्प्ले पैनल, एलईडी बैक लाइट, एंटेना से फाइनल परीक्षण।
डीवीडी ड्राइव	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
पावर अडैप्टर	घरेलू पीसीबी असेंबली के साथ आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित पूर्जों और संघटकों से फाइनल घरेलू असेंबली* और परीक्षण, इस शर्त के अध्यधीन है कि "पावर अडैप्टर" की असेंबली में इस्तेमाल होने वाले घरेलू स्तर पर विनिर्मित पूर्जों और संघटकों का मूल्य न्यूनतम 40% होगा ("पावर अडैप्टर" के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले कलपुर्जों और संघटकों के कुल मूल्य का)।
बेयर पीसीबी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू रूप से विनिर्मित।
कीबोर्ड/टचपैड और/या ट्रैकपॉइंट	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण।
बैटरी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण।
बॉटम कवर, बैक कवर, कीबोर्ड फेस बेजेल और डिस्प्ले फेस बेजेल और हिंगेस सहित लैपटॉप के कैबिनेट/चेसिस	आयातित/घरेलू इनपुट का उपयोग करके इंजेक्शन मोल्डिंग / स्टांपिंग के माध्यम से घरेलू स्तर पर विनिर्मित।
(i) फाइनल असेंबली/परीक्षण और (ii) डिजाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बली/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

*यह आवश्यक है कि एसएमटी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए बेयर पीसीबी पर सीपीयू (एस)/जीपीयू/प्रोसेसर (एस) कलपुर्जों/संघटकों के प्रिटेड सर्किट बोर्ड की असेंबली (पीसीबीए) अनिवार्य रूप से भारत में की जानी चाहिए।

**भारत में सेमीकंडक्टर फैब चालू होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

4.4 कंप्यूटर मॉनिटर

(क) परिभाषा :

इस अधिसूचना के प्रयोजन से, एक कंप्यूटर मॉनिटर (जिसे आमतौर पर बाजार में मॉनिटर के रूप में जाना जाता है) में एक एलसीडी/एलईडी डिस्प्ले असेंबली, लॉजिक कार्ड, पावर सप्लाई अडैप्टर और कैबिनेट होता है जो इसे डेस्कटॉप पीसी या लैपटॉप पीसी से कनेक्ट करने के लिए डिस्प्ले पोर्ट से युक्त होता है।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र :

कंप्यूटर मॉनिटर का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम के प्रमुख इनपुट/कंप्यूटर मॉनिटर के विनिर्माण के लिए चरण	घरेलू बीओएम के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले इनपुट के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन/स्थानीय सामग्री
1	2
लॉजिक कार्ड/माइक्रो कंट्रोलर	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण, जिसमें सेमीकंडक्टर्स का मूल्य शामिल है और बेयर पीसीबी का मूल्य शामिल नहीं है।
एलसीडी/एलईडी पैनल	कैबिनेट/चेसिस के मूल्य को छोड़कर, मॉनिटर कैबिनेट/चेसिस में आयातित/घरेलू रूप से एकत्रित एलसीडी/एलईडी पैनल *** का घरेलू एकीकरण और परीक्षण । हालाँकि, एलसीडी/एलईडी पैनल के कुल मूल्य का भार कंप्यूटर मॉनिटर के कुल बीओएम के 35% से अधिक नहीं होगा।
केबल्स	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्मित और परीक्षण किया गया।
पावर अडैप्टर	घरेलू पीसीबी असेंबली के साथ आयातित/ घरेलू स्तर पर विनिर्मित पूर्जों और संघटकों से फाइनल घरेलू असेंबली* और परीक्षण, इस शर्त के अध्यधीन है कि "पावर अडैप्टर" की असेंबली में इस्तेमाल होने वाले घरेलू स्तर पर विनिर्मित पूर्जों और संघटकों का मूल्य न्यूनतम 40% होगा ("पावर अडैप्टर" के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले कलपुर्जों और संघटकों के कुल मूल्य का)।
बेयर पीसीबी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू रूप से विनिर्मित।
कैबिनेट/चेसिस	मॉनिटर बेज़ेल, बैक कवर, स्टैंड, बेस और चेसिस जिसमें प्लास्टिक मोल्डिंग और धातु के हिस्सों की स्टैम्पिंग को आयातित/घरेलू इनपुट का उपयोग करके घरेलू स्तर पर किया जाता है।

(i) फाइनल असेंबली/परीक्षण और (ii) डिजाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।
---	---

*यह आवश्यक है कि एसएमटी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए बेयर पीसीबी पर सीपीयू (एस)/जीपीयू/प्रोसेसर (एस) कलपुर्जों/संघटकों के प्रिटेड सर्किट बोर्ड की असेंबली (पीसीबीए) अनिवार्य रूप से भारत में की जानी चाहिए।

**भारत में सेमीकंडक्टर फैब चालू होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

*** इसकी समीक्षा तब की जाएगी जब भारत में कंप्यूटर मॉनिटर्स (प्रत्येक आकार और प्रकार के) का एलसीडी / एलईडी पैनल विनिर्माण संचालन में हो।

4.5 टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर (पीसी)

क. परिभाषा :

इस अधिसूचना के प्रयोजन से, एक टैबलेट पीसी में आवश्यक रूप से एक एकीकृत मदरबोर्ड जिसमें सीपीयू/प्रोसेसर, मेमोरी और पावर मॉड्यूल और बोर्ड होंगे शामिल होगा; डिस्प्ले पैनल (टच पैनल + एलसीडी/एलईडी मॉड्यूल) और एकीकृत बैटरी होंगे और यह स्वतंत्र रूप से संचालित करने में सक्षम होना चाहिए।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र :

टैबलेट पीसी का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, वशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम के प्रमुख इनपुट/टैबलेट पीसी के विनिर्माण के लिए चरण	घरेलू बीओएम के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले इनपुट के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन/स्थानीय सामग्री
1	2
आँन बोर्ड सीपीयू/जीपीयू/प्रोसेसर के साथ इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण, जिसमें सेमीकंडक्टर्स** और प्रोसेसर/ सीपीयू/जीपीयू* का मूल्य शामिल है और बेयर पीसीबी का मूल्य इसमें शामिल नहीं है। हालाँकि, सीपीयू के कुल मूल्य का भार टैबलेट पीसी के कुल बीओएम के 35% से अधिक नहीं होगा।
मेमोरी और पावर मॉड्यूल	बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर, आयातित/ घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण।
डिस्प्ले पैनल (टच पैनल + एलसीडी/एलईडी मॉड्यूल)	आयातित/घरेलू रूप से विनिर्मित टच पैनल, एलसीडी/एलईडी मॉड्यूल या संयोजन से घरेलू असेंबली और परीक्षण, इस शर्त के अध्यधीन है कि डिस्प्ले पैनल का बैकलाइट असेंबली और परीक्षण घरेलू स्तर पर किया जाएगा।
पावर अडैप्टर	घरेलू पीसीबी असेंबली के साथ, आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित पूर्जों और संघटकों से फाइनल घरेलू असेंबली और परीक्षण, इस शर्त के अध्यधीन है कि "पावर अडैप्टर" की असेंबली में इस्तेमाल होने वाले घरेलू स्तर पर विनिर्मित

	कलपूर्जों और संघटकों का मूल्य न्यूनतम 40% होगा ("पावर अडैप्टर" के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले कलपूर्जों और संघटकों के कुल मूल्य का)।
बेयर पीसीबी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू रूप से विनिर्मित।
केसिंग	घरेलू स्तर पर विनिर्मित केसिंग।
बैटरी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपूर्जों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
ऐक्सेसरी (कैमरा, स्पीकर, वाईफाई एंटीना, आदि)	आयातित/घरेलू स्तर पर कलपूर्जों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
(i) फाइनल असेंबली/परीक्षण और (ii) डिजाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेंबली/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

*यह आवश्यक है कि एसएमटी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए बेयर पीसीबी पर सीपीयू (एस)/जीपीयू/प्रोसेसर(एस) कलपूर्जों/संघटकों के प्रिटेड सर्किट बोर्ड की असेंबली (पीसीबीए) अनिवार्य रूप से भारत में की जानी चाहिए।

**भारत में सेमीकंडक्टर फैब चालू होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

4.6 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर

(क) परिभाषा :

डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का प्रभावी प्रिंटर है, जो 0.2 मिमी से 0.3 मिमी के व्यास के धातु पिन द्वारा कागज पर डॉट बनाता है, जो सोलनॉइड सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा संचालित होता है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटहेड केन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रिजोल्यूशन द्वारा अपेक्षित कैरेक्टर का मैट्रिक्स उत्पन्न होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पिन के यांत्रिक दबाव के आधार पर कार्बन प्रतियां और कार्बन रहित प्रतियां बना सकता है।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र :

डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, वशर्ते कि इनपुट अलग- अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम के प्रमुख इनपुट/डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के विनिर्माण के लिए चरण	घरेलू बीओएम के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले इनपुट के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन/ स्थानीय सामग्री
1	2
मुख्य पीसीबी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपूर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण, इस शर्त के अधीन है कि "मुख्य पीसीबी" की असेंबली में प्रयुक्त घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपूर्जों और संघटकों का मूल्य न्यूनतम 15% होगा (मुख्य पीसीबी के विनिर्माण में प्रयुक्त कलपूर्जों और संघटकों के कुल मूल्य का), बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर।
बेयर पीसीबी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू रूप से विनिर्मित।

एसएमपीएस	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपूजों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण, इस शर्त के अध्यधीन है कि "एसएमपीएस" की असेंबली में इस्तेमाल होने वाले घरेलू स्तर पर विनिर्मित कल-पूजों और संघटकों का मूल्य न्यूनतम 20% होगा ("एसएमपीएस" के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले कलपूजों और संघटकों के कुल मूल्य का)।
कैरिज मोटर्स और पेपर फीड मोटर्स	उप-असेंबली के रूप में आयात किया गया और मुख्य प्रिंटर तंत्र के साथ घरेलू रूप से परीक्षण किया गया।
फ्रेट कंट्रोल पैनल	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपूजों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
होम पोजीशन / पेपर एंड सेंसर	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपूजों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
मुख्य प्रिंटर कैबिनेट और अन्य छोटे प्लास्टिक घटक	प्रिंटर कैबिनेट और अन्य भागों के घरेलू मोलिंडिंग।
प्रिंटर मेकेनिज़म असेंबली	घरेलू स्तर पर विनिर्मित रबर प्लेट्स, छोटे रबर भागों, शीट धातु के घटकों, प्लास्टिक गियर और टण्ड स्टील शाफ्ट के साथ अन्य प्लास्टिक भागों और ऊपर वर्णित सेंसर और मोटर्स का उपयोग करके घरेलू असेंबली।
प्रिंट हेड्स और इंटरकनेक्टिंग केबल्स	उप-असेंबली के रूप में आयात किया गया और मुख्य प्रिंटर तंत्र के साथ घरेलू रूप से परीक्षण किया गया।
(i) फाइनल असेंबली/परीक्षण और (ii) डिजाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

* यह आवश्यक है कि एसएमटी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए बेयर पीसीबी पर कल पूजों/संघटकों के प्रिटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) अनिवार्य रूप से भारत में किया जाना चाहिए।

4.7 स्मार्ट कार्ड

(क) परिभाषा :

इस अधिसूचना के प्रयोजन से, स्मार्ट कार्ड आमतौर पर एक क्रेडिट कार्ड के आकार का प्लास्टिक कार्ड होता है, जिसमें एक एकीकृत सर्किट (आईसी) होता है। इस आईसी में एक माइक्रोप्रोसेसर और मेमोरी होती है। स्मार्ट कार्ड संपर्क, संपर्क रहित या दोहरे इंटरफ़ेस (संपर्क और संपर्क रहित दोनों) पर आधारित हो सकते हैं। स्मार्ट कार्ड के कुछ अनुप्रयोगों में पहचान पत्र, बैंकिंग कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, वाहन पंजीकरण कार्ड आदि हैं।

I (ख) कॉटैक्ट स्मार्ट कार्ड के लिए स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र

कॉटैक्ट स्मार्ट कार्ड का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम के प्रमुख इनपुट/कॉन्टैक्ट स्मार्ट कार्ड के विनिर्माण के लिए चरण	घरेलू बीओएम के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले इनपुट के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन/स्थानीय सामग्री
1	2
प्लास्टिक कार्ड बॉडी	आयातित/घरेलू रूप से विनिर्मित, कलपुर्जों और संघटकों का उपयोग करके शीट कटिंग और पंचिंग, प्रिंटिंग, लेमिनेशन और परीक्षण सहित घरेलू विनिर्माण ।
आईसी चिप मॉड्यूल	आयातित/घरेलू रूप से विनिर्मित कच्चे माल, कलपुर्जों और संघटकों का उपयोग करते हुए, आईसी चिप मॉड्यूल* की घरेलू असेंबली, पैकेजिंग और परीक्षण।
प्लास्टिक कार्ड पर आईसी चिप मॉड्यूल की मिलिंग और एंबेडिंग	प्लास्टिक कार्ड पर आईसी चिप मॉड्यूल की मिलिंग और एंबेडिंग घरेलू स्तर पर करना।
(i) फाइनल असेंबली और टेस्टिंग (ii) डिजाइन / विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो । उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

* भारत में सेमीकंडक्टर फैब चालू होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

II (ख) कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड के लिए स्थानीय सामग्री की गणना के लिए क्रियाविधि

कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम में प्रमुख इनपुट/कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन/स्थानीय सामग्री
1	2
प्लास्टिक कार्ड बॉडी	आयातित/घरेलू रूप से विनिर्मित कच्चे माल, कलपुर्जों और संघटकों का उपयोग करके शीट कटिंग और पंचिंग, प्रिंटिंग, लेमिनेशन और परीक्षण सहित घरेलू विनिर्माण ।
कार्ड इनले (एंटीना)	घरेलू स्तर पर विनिर्मित आयातित कच्चे माल, कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
आईसी चिप मॉड्यूल	आयातित/घरेलू रूप से विनिर्मित कच्चे माल, कलपुर्जों और संघटकों का उपयोग करके आईसी चिप* मॉड्यूल की घरेलू असेंबली, पैकेजिंग और परीक्षण।
प्लास्टिक कार्ड पर आईसी चिप मॉड्यूल की मिलिंग और एंबेडिंग	प्लास्टिक कार्ड पर आईसी चिप मॉड्यूल की मिलिंग और एंबेडिंग घरेलू स्तर पर करना ।
(i) फाइनल असेंबली और टेस्टिंग (ii) डिजाइन / विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो । उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

* भारत में सेमीकंडक्टर फैब चालू होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

4.8 एलईडी उत्पाद

(क) परिभाषा :

इस अधिसूचना के प्रयोजन से, एलईडी उत्पाद वे हैं जिनका कार्य एलईडी द्वारा उत्पादित प्रकाश का उपयोग करना और निम्नलिखित क्षेत्रों में इसका उपयोग बढ़ाना है:- (i) रोशनी, (ii) टू एलईडी टीवी सहित ऑप्टिकल डिस्प्ले, (iii) बैकलाइटिंग, (iv) सिग्नलिंग और इंडिकेशन और (v) परिवहन।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए क्रियाविधि :

एलईडी उत्पादों का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें: हालाँकि, (घ) हीट सिंक या थर्मल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, (ड) सेकेंडरी ऑप्टिक्स और (च) सिस्टम फिक्सेटर और फिटिंग के कुल मूल्य का भार एलईडी उत्पाद के कुल बीओएम से 20% से अधिक नहीं होगा:

बीओएम के प्रमुख इनपुट/एलईडी उत्पादों के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने वाले के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन
1	2
एलईडी एमिटर	आयातित/घरेलू रूप से विनिर्मित बेयर एलईडी डाई से पैकेजिंग, इस शर्त के अधीन है कि बेयर एलईडी डाई को आयातित/घरेलू विनिर्मित आदानों का उपयोग करके घरेलू रूप से विनिर्मित किया जाएगा।
ड्राइविंग इलेक्ट्रॉनिक्स	घरेलू असेंबली* और आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपूर्जों और संघटकों से परीक्षण, इस शर्त के अध्यधीन है कि "ड्राइविंग इलेक्ट्रॉनिक्स" की असेंबली में इस्तेमाल होने वाले घरेलू स्तर पर विनिर्मित कल-पूर्जों और संघटकों (बेयर पीसीबी का मूल्य छोड़कर) का मूल्य न्यूनतम 30% होगा ("ड्राइविंग इलेक्ट्रॉनिक्स" के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले कलपूर्जों और संघटकों के कुल मूल्य का)।
एमसीपीसीबी सहित बेयर पीसीबी	घरेलू रूप से आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट का उपयोग करके विनिर्मित।
हीट सिंक या थर्मल प्रबंधन समाधान	घरेलू रूप से आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट का उपयोग करके विनिर्मित।
माध्यमिक प्रकाशिकी	घरेलू रूप से आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट का उपयोग करके विनिर्मित।
सिस्टम फिक्सर और फिटिंग	घरेलू तौर पर विनिर्मित।
फाइनल असेंबली/परीक्षण	समय-समय पर अधिसूचित भारतीय मानकों के अनुसार घरेलू रूप से असेंबली/परीक्षण किए गए।

4.9 बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल/ऑथेंटिकेशन डिवाइस

(क) परिभाषा :

इस अधिसूचना के प्रयोजन से, बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल/ऑथेंटिकेशन डिवाइस में अन्य बातों के साथ-साथ एक फिंगर प्रिंट सेंसर/आइरिस सेंसर, नियंत्रक मॉड्यूल और बिजली की आपूर्ति शामिल होगी। इसमें डिस्प्ले यूनिट हो सकती है या नहीं भी। बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल/ऑथेंटिकेशन डिवाइस के कुछ एप्लिकेशन फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, टाइम और अटेंडेंस कंट्रोल आदि हैं।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र :

बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल/ऑथेंटिकेशन डिवाइस का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम के प्रमुख इनपुट बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल/ऑथेंटिकेशन डिवाइस के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने वाले के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन
1	2
फिंगर प्रिंट सेंसर/आइरिस सेंसर	घरेलू स्तर पर विनिर्मित जैसा कि अधिसूचित है (पैराग्राफ 4.10 और 4.11 को देखें)।
मुख्य पीसीबी (नियंत्रक मॉड्यूल)	घरेलू असेंबली और आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपूर्जों और संघटकों से परीक्षण, बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर।
बेअर पीसीबी	आयातित/घरेलू स्तर पर विविनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विविनिर्मित।
बिजली की आपूर्ति/बैटरी (यदि अलग हो)	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपूर्जों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
डिस्प्ले यूनिट	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपूर्जों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
वैकल्पिक विशेषताएं जैसे कि कैमरा, कीबोर्ड, आरएफआईडी, स्मार्ट कार्ड रीडर, जीपीआरएस मॉड्यूल, वाई-फाई, ब्लू टूथ आदि।	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपूर्जों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
प्लास्टिक हाउसिंग	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्मित।
युएसबी केबल्स	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्मित।
(i) फाइबर असेंबली और परीक्षण (ii) डिजाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेंबल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

4.10 बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर

(क) परिभाषा :

इस अधिसूचना के उद्देश्य से, बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर में एक नियंत्रक मॉड्यूल, सीएमओएस सेंसर और ऑप्टिक्स शामिल हैं। बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर के अनुप्रयोग व्यक्तिगत पहचान और सत्यापन आदि हैं।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र:

बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर की घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम के प्रमुख मुख्य इनपुट/बॉयोमीट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर के निर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने वाले के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन
1	2
मुख्य पीसीबी (नियंत्रक मॉड्यूल)	बैअर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर आयातित / घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपूजों और संघटकों का उपयोग करके घरेलू असेंबली और परीक्षण।
ऑप्टिक्स	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्मित।
सीएमओएस सेंसर	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से उपयोग करके सीएमओएस सेंसर की घरेलू असेंबली, पैकेजिंग और परीक्षण*।
बैअर पीसीबी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्माण।
प्लास्टिक हाउसिंग	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्माण।
यूएसबी केबल्स	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्माण।
(i) फाइबल असेंबली और टेस्टिंग (ii) डिजाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

* भारत में सेमीकंडक्टर फैब चालू होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

4.11 बायोमेट्रिक आइरिस सेंसर

(क) परिभाषा :

इस अधिसूचना के उद्देश्य से, बॉयोमीट्रिक आइरिस सेंसर में एक नियंत्रक मॉड्यूल, सीएमओएस सेंसर और ऑप्टिक्स शामिल हैं। बायोमेट्रिक आइरिस सेंसर के आवेदन व्यक्तिगत पहचान और सत्यापन आदि हैं।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र:

बायोमेट्रिक आइरिस सेंसर का का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम के प्रमुख इनपुट/बॉयोमीट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने वाले के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन
1	2
मुख्य पीसीबी (नियंत्रक मॉड्यूल)	बैअर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर आयातित / घरेलू स्तर पर विनिर्मित भागों और संघटकों का उपयोग करके घरेलू असेंबली और परीक्षण।
ऑप्टिक्स	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्मित।

सीएमओएस सेंसर	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से उपयोग करके सीएमओएस सेंसर की घरेलू असेंबली, पैकेजिंग और परीक्षण *
बेअर पीसीबी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्माण।
प्लास्टिक हाउसिंग	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्माण।
यूएसबी केबल्स	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्माण।
(i) फाइनल असेंबली और परीक्षण (ii) डिजाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

* भारत में सेमीकंडक्टर फैब चालू होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

4.12 सर्वर

(क) परिभाषा :

इस अधिसूचना के प्रयोजन से, एक सर्वर में आवश्यक रूप से एक मदर बोर्ड, सीपीयू, मेमोरी (रैम), हार्ड डिस्क ड्राइव (एचडीडी)/सॉलिड स्टेट स्टोरेज ड्राइव (एसएसएसडी), पावर सप्लाई यूनिट (एसएमपीएस), चेसिस, कनेक्टिंग केबल्स और फर्मवेयर और ओएस शामिल होंगे।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र :

सर्वर की घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम के प्रमुख इनपुट/सर्वर के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने वाले के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन
1	2
सर्वर बोर्ड/मदर बोर्ड और सीपीयू(एस)/जीपीयू (एस)	सेमीकंडक्टर्स** और सीपीयू (एस)/जीपीयू (एस)को शामिल करके** और बेअर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित भागों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण
मेमोरी मॉड्यूल	पीसीबी असेंबली और बेअर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर, आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित बेअर पीसीबी आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित मेमोरी चिप्स** और कलपुर्जों/संघटकों से घरेलू परीक्षण।
हार्ड डिस्क ड्राइव/सॉलिड स्टेट स्टोरेज ड्राइव (एसएसडी)	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित भागों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
कैबिनेट + एसएमपीएस	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित भागों और संघटकों से घरेलू रूप से घरेलू स्तर पर विनिर्मित कैबिनेट और एसएमपीएस का घरेलू असेंबली और परीक्षण, इस शर्त के

	अध्यधीन कि "एसएमपीएस" की असेंबली में उपयोग किए गए घरेलू स्तर पर विनिर्मित भागों और संघटकों का मूल्य न्यूनतम 25% होगा ("एसएमपीएस" के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले भागों और संघटकों का कुल मूल्य)
बेअर पीसीबी	आयातित/घरेलू विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्मित
सहायक उपकरण (पावर केबल, कनेक्टर्स, आदि)	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित भागों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
(i) फाइनल असेंबली और टेस्टिंग (ii) डिजाइन और विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

* यह आवश्यक है कि सीपीयू (एस) /जीपीयू (एस) /प्रोसेसर (एस) के प्रिटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए), एसएमटी प्रक्रिया का उपयोग कर बेअर पीसीबी पर भागों/संघटकों को अनिवार्य रूप से भारत में किया जाना चाहिए।

** भारत में सेमीकंडक्टर फैब चालू होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

4.13 सेल्युलर मोबाइल फ़ोन

(क) परिभाषा :

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, एक सेल्युलर मोबाइल फोन (फीचर फोन या स्मार्ट फोन) में मुख्य रूप से मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी), बैटरी पैक, डिस्प्ले यूनिट, कुंजी पैड/टच पैनल, चार्जर/एडाप्टर, माइक्रोफोन और रिसीवर वाइब्रेटर मोटर/रिंगर और मैकेनिक्स शामिल होंगे।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र :

सेल्युलर मोबाइल फ़ोनों के घरेलू बीओएम में निम्न तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत का योग होगा, वशर्ते इनपुट व्यक्तिगत रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्य अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करते हैं:

बीओएम के प्रमुख इनपुट/सेल्युलर मोबाइल फोन के निर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने वाले के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन /स्थानीय सामग्री
1	2
मुख्य पीसीबी*	प्रोसेसर/सेमीकंडक्टर** बीओएम(यानी मेन पीसीबी पर सेमीकंडक्टर चिप्स और मॉड्यूल),को शामिल करके और बेअर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर ,आयातित / घरेलू स्तर पर विनिर्मित भागों और संघटकों से घरेलू असेंबलीऔर परीक्षण।
बैटरी पैक	आयात सामग्री की घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
चार्जर/एडाप्टर	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
वायर्ड हेडसेट	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
यांत्रिकी***	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
डाई कट कल्पुर्जे***	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
माइक्रोफोन और रिसीवर	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
की-पैड	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।

यूएसबी केबल	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
कैमरा मॉड्यूल	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
कलेक्टर्स	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
डिस्प्ले यूनिट	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
टच पैनल/कवर ग्लास असेंबली	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
वाइब्रेटर मोटर/रिंगर	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
(i) अंतिम असेंबली और परीक्षण (ii) डिजाइन और विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

*यह आवश्यक है कि एसएमटी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए बेयर पीसीबी पर संसाधक/संघटक की प्रिटेंड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) अनिवार्य रूप से भारत में की जानी चाहिए।

** भारत में सेमीकंडक्टर फैब प्रचालनरत होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

*** अनुबंध का संदर्भ लें।

5. अधिसूचना तुरंत प्रभाव से लागू है। संशोधित अधिसूचना जारी होने तक यह अधिसूचना मान्य रहेगी।

6. सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 के तहत कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा।

7. उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की क्रय के लिए दिनांक 04.06.2020 के सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार क्रय वरीयता प्रदान की जाएगी।

8. यदि भारत सरकार द्वारा परियोजना या योजना पूरी तरह से या आंशिक रूप से वित्त पोषित होती है, तो राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की क्रय के लिए अधिसूचना सभी केंद्रीय योजनाओं (सीएस) / केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (सीएसएस) पर भी लागू होगी।

9. स्थानीय सामग्री/घरेलू मूल्यवर्धन की गणना करने हेतु प्रक्रिया

9.1 घरेलू विनिर्माताओं (डीओएम-बीओएम) से प्राप्त सामग्री के बिल की गणना उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक के आधार पर की जा सकती है। इनमें से प्रत्येक गणना के सुसंगत परिणाम प्राप्त होने चाहिए।

क. सभी इनपुटों की लागतों का योग जो उस उत्पाद को बनाने के लिए आवश्यक है (इनपुटों की क्रय पर लगाए गए शुल्क और करों सहित, सिवाय उनको छोड़कर जिनके लिए क्रेडिट/सेट-ऑफ का लाभ लिया जा सकता है) और जिनका आयात प्रत्यक्ष रूप से या घरेलू व्यापारी या माध्यस्थ के माध्यम से नहीं किया गया है।

ख. उत्पाद के फैक्ट्री बाह्य मूल्य से उत्पाद के उत्पादन में इनपुटों के रूप में उपयोग की गई सामग्री के आयातित बिल (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) को घटाकर (इनपुटों की क्रय पर लगाए गए शुल्क और करों सहित, सिवाय उनको छोड़कर जिनके लिए क्रेडिट/सेट-ऑफ का लाभ लिया जा सकता है) और उसमें से वारंटी लागत को घटाकर।

ग. बाजार मूल्य से उत्पादन पश्चात मालभाडा, बीमा और अन्य हथालन लागतों को घटाकर, उसमें से कर पश्चात लाभ, वारंटी लागत को घटाया जाता है, उसमें से उत्पादों के उत्पादन (इनपुटों की क्रय पर लगाए गए शुल्क और करों सहित, सिवाय उनको छोड़कर जिनके लिए क्रेडिट/सेट-ऑफ लिया जा सकता है) में इनपुटों के रूप में उपयोग की गई सामग्री के आयातित बिल के योग को घटाया जाता है और बिक्री और विपणन खर्च को घटाया जाता है।

9.2 सामग्री के कुल बिल (कुल-बीओएम) की गणना उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित में से किसी एक के आधार पर की जा सकती है। इनमें से प्रत्येक गणना के सुसंगत परिणाम प्राप्त होने चाहिए।

क. सभी इनपुटों की लागतों का योग जो उस उत्पाद को बनाने के लिए आवश्यक है (इनपुटों की क्रय पर लगाए गए शुल्क और करों सहित, सिवाय उनको छोड़कर जिनके लिए क्रेडिट/सेट-ऑफ का लाभ लिया जा सकता है)।

ख. उत्पाद के फैक्टरी बाह्य मूल्य से कर पश्चात लाभ और वारंटी लागतों को घटाया जाता है।

ग. बाजार मूल्य से उत्पादन पश्चात मालभाड़ा, बीमा और अन्य हथालन लागतों को घटाकर उसमें से कर पश्चात लाभ, वारंटी लागत, बिक्री और विपणन खर्च घटाया जाता है।

9.3 निम्नलिखित फॉर्मूला के अनुसार प्रस्तुत जानकारी के आधार पर घरेलू मूल्य-वृद्धि के प्रतिशत की गणना की जा सकती है:

$$\text{स्थानीय सामग्री/घरेलू मूल्य-वृद्धि का प्रतिशत} = \frac{\text{डीओएम}-\text{बीओएम}}{\text{बुल}-\text{डीओएम}} \times 100$$

यह सिफारिश की जाती है कि आकलन करने वाली प्रत्येक एजेंसी को उपरोक्त सूत्रों में से कम से कम दो का उपयोग करके स्थानीय सामग्री/घरेलू मूल्य-वृद्धि की गणना करनी चाहिए ताकि इस संबंध में आकलन को मान्य किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि दावाकृत घरेलू मूल्य सुसंगत है।

10. स्थानीय सामग्री/घरेलू मूल्यवृद्धि का सत्यापन

क. निविदा, बोली प्रक्रिया या सिफारिश के समय स्थानीय आपूर्तिकर्ता स्व-प्रमाणन प्रदान करेगा कि प्रसतावित की गई वस्तुएं न्यूनतम स्थानीय सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और उस स्थान (स्थानों) का विवरण देगा, जिस पर स्थानीय मूल्य वृद्धि की गई है।

ख. 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की क्रय के मामलों में, स्थानीय आपूर्तिकर्ता स्थानीय सामग्री का प्रतिशत देते हुए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक (कंपनियों के मामले में) या लागत लेखापरीक्षक या किसी पेशेवर लागत लेखाकार या पेशेवर चार्टेड लेखाकार (कंपनियों के अलावा अन्य आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में) से एक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगा।

ग. यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के संबंध में स्थानीय सामग्री/घरेलू मूल्य वृद्धि के संबंध में बोलीकर्ता के दावे के खिलाफ क्रय एजेंसी या संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा शिकायत प्राप्त की जाती है, तो उसे एसटीक्यूसी के पास भेजा जाएगा।

घ. एसटीक्यूसी को संदर्भित कोई भी शिकायत 4 सप्ताह के भीतर निपटा दी जाएगी। बोलीकर्ता को एसटीक्यूसी हेतु किसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में दावा की गई घरेलू मूल्य वृद्धि के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। यदि बोलीकर्ता के द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो ऐसी प्रयोगशालाएं दावे की वास्तविकता को सिद्ध करने के लिए अगली आवश्यक कार्रवाई कर सकती हैं।

ङ. 2 लाख रुपए या खरीदे जा रहे घरेलू रूप से विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमत का 1% शिकायत शुल्क (5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन), जो भी अधिक हो, का डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाएगा, जो एसटीक्यूसी में जमा जमा होगा। यदि शिकायत गलत पाई जाती है, तो शिकायत शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। यदि, शिकायत को बरकरार रखा जाता है और काफी हद तक सही पाया जाता है तो शिकायतकर्ता को जमा शुल्क बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।

च. सामान्य वित्तीय नियमों के विनियम 175(1) (i) (h) के तहत अखंडता संहिता के उल्लंघन में झूठी घोषणाएं की जाएगी तो इसके लिए एक बोलीकर्ता या उसके उत्तराधिकारियों पर सामान्य वित्तीय नियमों के विनियम 151(iii) के अनुसार दो साल तक के लिए रोक लगा दी जाएगी, इसके साथ-साथ कानून के तहत स्वीकार्य होने वाली अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।

11. इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अधिसूचना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय एमईआईटीवाई होगा।

12. यदि प्रश्न उठता है कि क्या खरीदी जा रही कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है, जिसे सार्वजनिक क्रय (मेक इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 के तहत शामिल किया जाना है, तो इस मामले को स्पष्टीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को संदर्भित किया जाएगा।

अनुबंध**यान्त्रिकी और डाई कट कलपुर्जे की सूची****क. यान्त्रिकी (मैकेनिक्स)**

1. बैटरी कवर (एचएस 39209999)
2. फ्रंट कवर (एचएस 39209999)
3. फ्रंट कवर (जिंक कास्टिंग के साथ) (एचएस 39209999)
4. मिडल कवर (एचएस 39209999)
5. जीएसएम एंटीना/किसी भी प्रौद्योगिकी का एंटीना (एचएस 39209999)
6. साइड की (एचएस 85389000)
7. मेन लेंस (एचएस 39209999)
8. कैमरा लेंस (एचएस 39209999)
9. पेंच (एचएस 73181500)
10. माइक्रो रबर केस (एचएस 40169990)
11. सेंसर रबड़ केस/सीलबंद गैसकेटों सहित सीलबंद गैसकेट/रबड़ केस यानि एसबीआर, ईपीडीएम, सीआर, सीएस, सिलिकॉन और सभी अन्य विशेष रबड़ या संयोजन/रबड़ के संयोजन (एचएस 40169990)
 - 11.1 पीयू केस /सीलबंद गैसकेट (एचएस 39269091) - सीलबंदी गैसकेट/केस की तरह पॉलीयुरेथेन फोम की अन्य सामग्री।
 - 11.2 सीलबंदी गास्केट/पीई, पीपी, ईपीएस, पीसीसे केस और सभी अन्य विशेष बहुलक या संयोजन/बहुलकों का संयोजन(एच एस 39269099)
12. सिम सॉकेट/अन्य मैकेनिकल (यान्त्रिकी) मदें (धातु) (एचएस 73269099)
13. सिम सॉकेट/अन्य मैकेनिकल (यान्त्रिकी) मदें (प्लास्टिक) (एचएस 39269099)
14. बैक कवर (एचएस 39209999)

ख. डाई कट कलपुर्जे

1. सुचालक कपड़ा (एचएस 39269099)
2. ऊष्मा उत्सर्जक स्टीकर बैटरी कवर (एचएस 39199090)
3. स्टीकर-बैटरी स्लॉट (एचएस 39199090)
4. मैन लेंस के लिए प्रोटेक्टिव फिल्म (एचएस 39199090)
5. एलसीडी एफपीसी के लिए माइलर (एचएस 39199090)
6. एलसीडी सुचालक फोम (एचएस 39269099)
7. फिल्म-फ्रंट फ्लैश (एचएस 39199090)
8. एलसीडी फोम (एचएस 39269099)
9. बीटी फोम (एचएस 39269099)

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
(IPHW DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2020

Subject : Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017-Notifying Electronic Products in furtherance of the Order

Reference : Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) Order No. P-45021/2/2017-B.E.-II dated 15.06.2017, as amended by Orders dated 28.05.2018, 29.05.2019 and 04.06.2020

F. No. W-43/4/2019-IPHW-MeitY.—The Government has issued Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 vide the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) Order No. P-45021/2/2017-B.E.-II dated 15.06.2017, as amended by Orders dated 28.05.2018, 29.05.2019 and 04.06.2020, to encourage ‘Make in India’ and promote manufacturing and production of goods and services in India with a view to enhancing income and employment.

2. In furtherance of the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 [PPP-MII Order 2017] notified vide reference cited above, and in supersession of the Electronic Product Notification Nos.33(1)/2017-IPHW dated 14.09.2017 and 33(5)/2017-IPHW dated 01.08.2018 issued thereunder, the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) hereby notifies that preference shall be provided by all procuring entities to locally manufactured Electronic Products as per the aforesaid Order, as amended from time to time.

3. For the purpose of this notification:

- The definition of Class-I local supplier, Class-II local supplier and Non-local supplier shall be as per paragraph 2 of the DPIIT PPP-MII Order 2017 No.P-45021/2/2017-PP(BE-II) dated 04.06.2020, as amended from time to time. The mechanism for calculation of local content has been prescribed for each notified Electronic Product in this notification, in accordance with paragraph 5 of the DPIIT PPP-MII Order 2017 No.P-45021/2/2017-PP(BE-II) dated 04.06.2020, as amended from time to time.
- Paragraph 3A of the DPIIT PPP-MII Order 2017 No.P-45021/2/2017-PP(BE-II) dated 04.06.2020, as amended from time to time, shall be referred for percentage of procurement for which preference to domestically manufactured Electronic Products is to be provided (in value terms).

4. Following Electronic Products are notified under the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017:

4.1 Desktop Personal Computers (PCs)

(A) Definition:

For the purpose of this Notification, a Desktop PC shall necessarily consist of a CPU, Memory, Hard disk drive, Keyboard, Mouse and a separate or integrated display unit and should be able to operate independently.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of Desktop PC would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/stages for manufacture of Desktop PC	Value addition/local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Main Board / Motherboard and CPU / GPU	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured parts and components, including the value of Semiconductors** and CPU/ GPU** and excluding

	the value of bare PCB. However, the weightage of total value of CPU shall not exceed 30% of the total BOM of the Desktop PC.
Memory Module	Domestic PCB Assembly* and testing from imported / domestically manufactured memory chips** and parts / components on imported/ domestically manufactured bare PCB, excluding the value of bare PCB.
Hard Disk Drive / Solid State Drive (SSD)	Domestic PCB Assembly* and final product assembly and testing from imported / domestically manufactured parts and components, excluding the value of bare PCB.
LCD / LED Monitor	Domestic assembly and testing of LCD / LED Monitor from parts consisting of imported/domestically assembled LCD / LED Panel and Domestic PCB Assembly*, Domestic plastic moulding and Domestic stamping of metal parts, excluding the value of bare PCB.
DVD Drive	Domestic assembly and testing from imported / domestically manufactured parts and components.
Cabinet + SMPS	Domestically manufactured Cabinet and Domestic PCB Assembly* and the final assembly and testing of SMPS from imported/ domestically manufactured parts and components, subject to the condition that the domestically manufactured parts and components used in the assembly of “SMPS” will be minimum 20% (of the total value of parts and components used in the manufacture of “SMPS”).
Keyboard/Mouse	Domestic PCB Assembly* and the final assembly and testing from imported / domestically manufactured parts and components.
Bare PCB	Domestically manufactured from imported / domestically manufactured inputs.
(i) Final Assembly / Testing and (ii) Design / Development	(i) Domestically assembled/tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM.

* It is essential that the Printed Circuit Board Assembly (PCBA) of the CPU(s)/ GPU/ processor(s) parts/ components on the bare PCB using the SMT process should mandatorily be done in India.

** This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational.

4.2 Thin Clients

(A) Definition:

For the purpose of this Notification, a Thin Client (TC) shall necessarily consist of a CPU, Memory, DOM, Keyboard, Mouse and a separate or integrated display unit and should be able to operate independently.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of a Thin Client would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM / stages for manufacture of Thin Client	Value addition / local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Main Board / Motherboard and CPU	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured parts and components, including the value of Semiconductors** and CPU** and excluding the value of bare PCB. However, the weightage of total value of CPU shall not exceed 30% of the total BOM of the Thin Client.
Memory Module/ DOM	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured memory chips** and parts/ components on imported/ domestically manufactured bare PCB, excluding the value of bare PCB.
SMPS/ Power Adapter	Domestically PCB Assembly* and the final assembly and testing of SMPS/ Power Adapter from imported/ domestically manufactured parts and components, subject to the condition that the domestically manufactured parts and components used in the assembly of “SMPS” will be minimum 20% (of the total value of parts and components used in the manufacture of “SMPS”).
LCD/ LED Monitor	Domestic assembly and testing of LCD/ LED Monitor from parts consisting of imported/ domestically assembled LCD/ LED Panel and Domestic PCB Assembly*, Domestic plastic moulding and Domestic stamping of metal parts, excluding the value of bare PCB.
Cabinet	Domestically manufactured.
Keyboard/Mouse	Domestic PCB Assembly* and the final assembly and testing from imported / domestically manufactured parts and components.
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
(i) Final Assembly/ Testing and (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM.

* It is essential that the Printed Circuit Board Assembly (PCBA) of the CPU(s)/ processor(s)/ parts/ components on the bare PCB using the SMT process should mandatorily be done in India.

** This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational.

4.3 Laptop Personal Computers (PCs)

(A) Definition:

For the purpose of this Notification, a Laptop PC (commonly known in the market as Laptop/ Notebook/ Netbook/ Ultrabook, etc.) shall necessarily consist of a CPU, Memory, Hard disk drive, Keyboard, Touchpad and/ or Trackpoint, an integrated display unit, integrated battery and should be able to operate independently.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of a Laptop PC would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/ stages for manufacture of Laptop PC	Value addition/ local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Main Board/ Motherboard and CPU/ GPU	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured parts and components, including the value of Semiconductors** and CPU/ GPU** and excluding the value of bare PCB. However, the weightage of total value of CPU shall not exceed 35% of the total BOM of the Laptop PC.
Power Module	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
Memory Module	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured memory chips** and parts/ components on imported/ domestically manufactured bare PCB, excluding the value of bare PCB.
Hard Disk Drive/ Solid State Drive (SSD)	Domestic PCB Assembly* and final product assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components, excluding the value of bare PCB.
Display Panel (LCD, LED, etc.)	Domestic assembly into the Back Cover and Bezel and final testing from imported/ domestically assembled Display Panel, LED Back light, Antennae, excluding the value of the Back Cover and Bezel.
DVD Drive	Domestic assembly and testing from imported / domestically manufactured parts and components.
Power Adapter	Domestic assembly with domestic PCB Assembly* and final testing from imported/ domestically manufactured parts and components, subject to the condition that the value of domestically manufactured parts and components used in the assembly of “Power Adapter” will be minimum 40% (of the total value of parts and components used in the manufacture of “Power Adapter”).
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
Keyboard/ Touchpad and/ or Trackpoint	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
Battery	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
Cabinet/ Chassis of Laptop including bottom cover, back cover, Keyboard face bezel and Display face bezel and Hinges	Domestically manufactured through injection moulding/ stamping using imported/ domestic inputs.
(i) Final Assembly/ Testing and (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM.

* It is essential that the Printed Circuit Board Assembly (PCBA) of the CPU(s)/ GPU/ processor(s)/ parts/ components on the bare PCB using the SMT process should mandatorily be done in India.

** This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational.

4.4 Computer Monitors

(A) Definition:

For the purpose of this Notification, a Computer Monitor (commonly known in the market as Monitor) shall necessarily consist of a LCD/ LED Display assembly, Logic card, Power Supply Adaptor and Cabinet with Display Ports for connecting it to a Desktop PC or Laptop PC or Tablet PC.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of a Computer Monitor would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/ stages for manufacture of Computer Monitor	Value addition/ local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Logic Cards/ Micro controller	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured parts and components including value of Semiconductors** and excluding the value of bare PCB.
LCD/ LED Panel	Domestic integration and testing of imported/ domestically assembled LCD/ LED Panel*** into the Monitor Cabinet/ Chassis, excluding the value of the Cabinet/ Chassis. However, the weightage of total value of LCD/ LED Panel shall not exceed 35% of the total BOM of the Computer Monitor.
Cables	Domestically manufactured and tested from imported/ domestically manufactured inputs.
Power Adapter	Domestic assembly with domestic PCB Assembly* and final testing from imported/ domestically manufactured parts and components, subject to the condition that the value of domestically manufactured parts and components used in the assembly of “Power Adapter” will be minimum 40% (of the total value of parts and components used in the manufacture of “Power Adapter”).
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
Cabinet/ Chassis	The Monitor Bezel, Back cover, Stand, Base and Chassis wherein the plastic mouldings and the stamping of metal parts is done domestically using imported/ domestic inputs.
(i) Final Assembly/ Testing and (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM.

* It is essential that the Printed Circuit Board Assembly (PCBA) of the CPU(s)/ GPU processor(s)/ parts/ components on the bare PCB using the SMT process should mandatorily be done in India.

** This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational.

*** This shall be reviewed when LCD/LED Panel manufacturing of Computer Monitors (of each size and type) in India is operational.

4.5 Tablet Personal Computers (PCs)

A. Definition:

For the purpose of this Notification, a Tablet PC shall necessarily consist of an Integrated Motherboard with on board CPU/Processor, Memory and Power Module; Display Panel (Touch Panel + LCD/LED Module) and integrated battery and should be able to operate independently.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of Tablet PC would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/ stages for manufacture of Tablet PC	Value addition/ local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Integrated Motherboard with on board CPU/ GPU/ Processor	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured parts and components, including value of Semiconductors** and Processor/CPU/ GPU** and excluding the value of bare PCB. However, the weightage of total value of CPU shall not exceed 35% of the total BOM of the Tablet PC.
Memory and Power Module	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured parts and components, excluding the value of bare PCB.
Display Panel (Touch Panel + LCD/ LED Module)	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured Touch Panel, LCD/ LED Module or combination, subject to the condition that backlight assembly and testing of Display Panel shall be done domestically.
Power Adapter	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components, subject to the condition that the value of domestically manufactured parts and components used in the assembly of “Power Adapter” will be minimum 40% (of the total value of parts and components used in the manufacture of “Power Adapter”).
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
Casing	Domestically manufactured Casing.
Battery	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
Accessories (Camera, Speaker, WiFi Antenna, etc.)	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
(i) Final Assembly/ Testing and (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM.

* It is essential that the Printed Circuit Board Assembly (PCBA) of the CPU/ GPU/ processor/ parts/ components on the bare PCB using the SMT process should mandatorily be done in India.

** This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational

4.6 Dot Matrix Printers

(A) Definition:

A Dot Matrix Printer is a type of impact printer that forms dot on paper by a metal pin of diameter 0.2 mm to 0.3 mm which is driven by electromagnet based on solenoid principle and required character matrix is produced by horizontal and vertical resolution of dot matrix printhead. Dot Matrix Printer can create carbon copies and carbonless copies based on mechanical pressure of pin.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of a Dot Matrix Printer would be the sum of the cost of main inputs specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/ stages for manufacture of Dot Matrix Printer	Value addition/ local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Main PCB	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured parts and components, subject to the condition that value of domestically manufactured parts and components used in the assembly of “Main PCB” will be minimum 15% (of the total value of parts and components used in the manufacture of “Main PCB”), excluding the value of bare PCB.
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
SMPS	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components, subject to the condition that value of domestically manufactured parts and components used in the assembly of “SMPS” will be minimum 20% (of the total value of parts and components used in the manufacture of “SMPS”).
Carriage Motors and Paper Feed Motors	Imported as sub-assembly and tested domestically along with main Printer Mechanism.
Front Control Panel	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
Home Position/Paper End Sensors	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
Main Printer Cabinet and other small plastic components	Domestic moulding of Printer Cabinet and other parts.
Printer Mechanism Assembly	Domestic assembly using domestically manufactured Rubber Platens, small rubber parts, sheet metal components, plastic gears and other plastic parts with turned steel shafts and above mentioned sensors and Motors.
Print Heads and Interconnecting Cables	Imported as sub-assembly and tested domestically along with main Printer Mechanism.
(i) Final Assembly/ Testing and (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM.

* It is essential that the Printed Circuit Board Assembly (PCBA) of the parts/ components on the bare PCB using the SMT process should mandatorily be done in India.

4.7 Smart Cards

(A) Definition:

For the purpose of this Notification, Smart Card is usually a Credit Card sized plastic Card with an Integrated Circuit (IC) contained inside. The IC contains a microprocessor and memory. Smart Cards can be contact, contactless or dual interface (both contact and contactless). Some of the applications of Smart Card are Identity Card, Banking Card, Health Card, Vehicle Registration Card etc.

I(B) Mechanism for calculation of local content for Contact Smart Cards

The domestic Bill of Material (BOM) of a Contact Smart Card would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/ stages for manufacture of Contact Smart Card	Value addition/ local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Plastic Card Body	Domestic manufacturing including sheet cutting & punching, printing, lamination and testing using imported/ domestically manufactured raw material, parts and components.
IC Chip Module	Domestic assembly, packaging and testing of IC Chip Module using imported/ domestically manufactured raw material, parts and components*.
Milling and Embedding of IC Chip Module on Plastic Card	Milling and Embedding of IC Chip Module on Plastic Card done domestically.
(i) Final Assembly and Testing (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items, including fusion of domestically developed Operating System. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM.

* This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational.

II(B) Mechanism for calculation of local content for Contactless Smart Cards

The domestic Bill of Material (BOM) of Contactless Smart Card would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/stages for manufacture of Contactless Smart Card	Value addition/local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Plastic Card Body	Domestic manufacturing including sheet cutting & punching, printing, lamination and testing using imported/ domestically manufactured raw material, parts and components.
Card inlay (Antenna)	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured raw material, parts and components.
IC Chip Module	Domestic assembly, packaging and testing of IC Chip Module using imported/ domestically manufactured raw material, parts and components*.
Milling and Embedding of IC Chip Module on Plastic Card	Milling and Embedding of IC Chip Module on Plastic Card done domestically.

(i) Final Assembly and Testing (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items, including fusion of domestically developed Operating System. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM.
--	--

* This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational.

4.8 LED Products

(A) **Definition:**

For the purpose of this Notification, LED products are those whose function is to utilize light produced by LEDs and spanning applications in the areas of: (i) Illumination, (ii) Optical Displays including True LED TVs, (iii) Backlighting, (iv) Signalling & Indication and (v) Transportation.

(B) **Mechanism for calculation of local content:**

The domestic Bill of Material (BOM) of LED Products would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table. However, the weightage of total value of (d) Heat Sink or Thermal Management Solutions, (e) Secondary Optics and (f) System Fixture and Fitting shall not exceed 20% of the total BOM of the LED Product:

Main inputs in BOM/ stages for manufacture of LED Products	Value addition/ local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
LED Emitter	Packaging from imported/ domestically fabricated Bare LED Die, subject to the condition that the Bare LED Die shall be domestically fabricated using imported/ domestically manufactured inputs.
Driving Electronics	Domestic assembly from imported/ domestically manufactured parts and components, subject to the condition that the value of domestically manufactured parts and components (excluding the value of bare PCB) used in the assembly of “Driving Electronics” will be minimum 30% of the total value of parts and components used in the manufacture of “Driving Electronics”.
Bare PCB including MCPCB	Domestically manufactured using imported/ domestically manufactured inputs.
Heat Sink or Thermal Management Solutions	Domestically manufactured using imported/ domestically manufactured inputs.
Secondary Optics	Domestically manufactured using imported/ domestically manufactured inputs.
System Fixture and Fitting	Domestically manufactured.
Final Assembly/ Testing	Domestically assembled/ tested meeting Indian Standards as notified from time to time.

4.9 Biometric Access Control/Authentication Devices

(A) **Definition:**

For the purpose of this Notification, Biometric Access Control/ Authentication Device shall include *inter-alia* a Finger Print Sensor/ Iris Sensor, Controller Module and Power supply. It may or may not contain a display unit. Some of the applications of Biometric Access Control/ Authentication Device are Physical access control, Time and Attendance control etc.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of Biometric Access Control/ Authentication Device would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/ stages for manufacture of Biometric Access Control/ Authentication Device	Value addition/ local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Finger Print Sensor/ Iris Sensor	Domestically manufactured as notified (refer Paragraphs 4.10 and 4.11).
Main PCB (Controller Module)	Domestic assembly and testing from imported / domestically manufactured parts and components, excluding the value of bare PCB.
Bare PCB	Domestically manufactured from imported / domestically manufactured inputs.
Power Supply/ Battery(if separate)	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
Display Unit	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
Optional features such as Camera, Keyboard, RFID, Smart Card Reader, GPRS Module, Wi-Fi, Blue Tooth etc.	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
Plastic Housing	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
USB Cables	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
(i) Final Assembly and Testing (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM.

4.10 Biometric Finger Print Sensors**(A) Definition:**

For the purpose of this Notification, Biometric Finger Print Sensor consists of a Controller Module, CMOS Sensor and Optics. The applications of the Biometric Finger Print Sensor are personal identification and verification, etc.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of Biometric Finger Print Sensor would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/stages for manufacture of Biometric Finger Print Sensor	Value addition/local required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Main PCB (Controller Module)	Domestic assembly and testing using imported / domestically manufactured parts and components, excluding the value of bare PCB.

Optics	Domestically manufactured from imported / domestically manufactured inputs.
CMOS Sensor	Domestic assembly, packaging and testing of CMOS Sensor using imported/ domestically manufactured inputs*.
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
Plastic Housing	Domestically manufactured from imported / domestically manufactured inputs.
USB Cables	Domestically manufactured from imported / domestically manufactured inputs.
(i) Final Assembly and Testing (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM.

* This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational.

4.11 Biometric Iris Sensors

(A) **Definition:**

For the purpose of this Notification, Biometric Iris Sensor consists of a Controller Module, CMOS Sensor and Optics. The applications of the Biometric Iris Sensor are personal identification and verification, etc.

(B) **Mechanism for calculation of local content:**

The domestic Bill of Material (BOM) of Biometric Iris Sensor would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/stages for manufacture of Biometric Iris Sensor	Value addition/local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Main PCB (Controller Module)	Domestic assembly and testing using imported / domestically manufactured parts and components except value of bare PCB.
Optics	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
CMOS Sensor	Domestic assembly, packaging and testing of CMOS Sensor using imported/ domestically manufactured inputs*.
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
Plastic Housing	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
USB Cables	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
(i) Final Assembly and Testing (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM.

*This shall be reviewed when the Semiconductor Fab in India is operational.

4.12 Servers

(A) Definition:

For the purpose of this Notification, a Server shall necessarily consist of a Mother Board, CPU, Memory (RAM), Hard Disk Drive (HDD)/ Solid State Storage Drive (SSD), Power Supply Unit (SMPS), Chassis, Connecting Cables and Firmware & OS.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of a Server would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/ stages for manufacture of Server	Value addition /local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Server Board/ Mother Board and CPU(s)/ GPU(s)	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured parts and components, including the value of Semiconductors** and CPU(s)/ GPU(s)** and excluding the value of bare PCB.
Memory Module	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured memory chips** and parts/ components on imported/ domestically manufactured bare PCB, excluding the value of bare PCB.
Hard Disk Drive/ Solid State Storage Drive (SSD)	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
Cabinet + SMPS	Domestically manufactured Cabinet and domestic assembly and testing of SMPS from imported / domestically manufactured parts and components, subject to the condition that value of domestically manufactured parts and components used in the assembly of “SMPS” will be minimum 25% (of the total value of parts and components used in the manufacture of “SMPS”).
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
Accessories (Power Cables, Connectors, etc.)	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
(i) Final Assembly and Testing (ii) Design and Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in the domestic BOM.

* It is essential that the Printed Circuit Board Assembly (PCBA) of the CPU(s)/ GPU(s)/ processor(s), parts/ components on the bare PCB using the SMT process should mandatorily be done in India

** This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational.

4.13 Cellular Mobile Phones

(A) Definition:

For the purpose of this Notification, a Cellular Mobile Phone (Feature Phone or Smart Phone) shall necessarily consist of a Main Printed Circuit Board (PCB), Battery Pack, Display Unit, Key Pad/ Touch Panel, Charger/ Adapter, Microphone & Receiver, Vibrator Motor/ Ringer and Mechanics.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic BOM of Cellular Mobile Phones would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/stages for manufacture of Cellular Mobile Phone	Value addition/ local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Main PCB*	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components including Processor and Semiconductor** BOM (i.e the Semiconductor Chips and Modules on Main PCB), and excluding value of bare PCB.
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
Battery Pack	Domestic assembly and testing of imported/ domestically manufactured inputs.
Charger/ Adapter	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
Wired Headset	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
Mechanics***	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
Die Cut Parts***	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
Microphone and Receiver	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
Key Pad	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs
USB Cable	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
Camera Module	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
Connectors	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
Display Unit	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
Touch Panel/ Cover Glass Assembly	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
Vibrator Motor/ Ringer	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
(i) Final Assembly and Testing (ii) Design and Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in the domestic BOM.

* It is essential that the Printed Circuit Board Assembly (PCBA) of the processor/ components on the bare PCB using the SMT process should mandatorily be done in India.

** This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational

***Refer Annexure

5. The Notification comes into effect immediately. This Notification shall remain valid till the revised Notification is issued.

6. No Electronic Product Notification under the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 shall have retrospective effect.

7. Purchase Preference shall be provided as per the provisions cited in the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 dated 04.06.2020 for the procurement of aforesaid electronics products.

8. The notification would also be applicable to all Central Schemes (CS)/ Central Sector Schemes (CSS) for the procurement of electronic products made by States and local bodies, if project or scheme is fully or partially funded by Government of India.

9. Procedure for calculating local content/ domestic value addition

9.1 Bill of Material sourced from domestic manufacturers (Dom-BOM) may be calculated based on one of the followings depending on data available. Each of these calculations should provide consistent result.

a. Sum of the costs of all inputs which go into the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit/ set-off can be taken) and which have not been imported directly or through a domestic trader or an intermediary.

b. Ex-Factory Price of product minus profit after tax minus sum of imported Bill of Material used (directly or indirectly) as inputs in producing the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit/ set-off can be taken) minus warranty costs.

c. Market price minus post-production freight, insurance and other handling costs minus profit after tax minus warranty costs minus sum of Imported Bill of Material used as inputs in producing the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit / set-off can be taken) minus sales and marketing expenses.

9.2 Total Bill of Material (Total-BOM) may be calculated based on one of the following depending on data available. Each of these calculations should provide consistent result.

a. Sum of the costs of all inputs which go into the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit / set-off can be taken).

b. Ex-Factory Price of product minus profit after tax, minus warranty costs.

c. Market price minus post-production freight, insurance and other handling costs minus profit after tax, minus warranty costs minus sales and marketing expenses.

9.3 The percentage of domestic value-addition may be calculated based on information furnished as per the following formula:

$$\text{Percentage of local content/ domestic value-addition} = \frac{\text{Dom -BOM}}{\text{Total-BOM}} \times 100$$

It is recommended that each agency assessing should calculate the domestic local content/ value-addition using at least two of the above formulae so as to validate the assessments in this regard and ensure that the domestic value addition that is claimed is consistent.

10. Verification of local content/ Domestic Value Addition

a. The local supplier at the time of tender, bidding or solicitation shall provide self-certification that the item offered meets the minimum local content and shall give details of the location(s) at which the local value addition is made.

b. In cases of procurement for a value in excess of Rs. 10 crore, the local supplier shall provide a certificate from the statutory auditor or cost auditor of the company (in the case of companies) or from a practicing cost accountant or practicing chartered accountant (in respect of suppliers other than companies) giving the percentage of local content.

c. In case a complaint is received by the procuring agency or the concerned Ministry/Department against the claim of a bidder regarding local content/ domestic value addition in an electronic product, the same shall be referred to STQC.

d. Any complaint referred to STQC shall be disposed of within 4 weeks. The bidder shall be required to furnish the necessary documentation in support of the domestic value addition claimed in an electronic product to STQC. If no information is furnished by the bidder, such laboratories may take further necessary action, to establish the bona fides of the claim.

e. A complaint fee of Rs.2 Lakh or 1% of the value of the domestically manufactured electronic products being procured (subject to a maximum of Rs. 5 Lakh), whichever is higher, to be paid by Demand Draft to be deposited with STQC. In case, the complaint is found to be incorrect, the complaint fee shall be forfeited. In case, the complaint is upheld and found to be substantially correct, deposited fee of the complainant would be refunded without any interest.

f. False declarations will be in breach of the Code of Integrity under Rule 175(1)(i)(h) of the General Financial Rules for which a bidder or its successors can be debarred for up to two years as per Rule 151 (iii) of the General Financial Rules along with such other actions as may be permissible under law.

11. MeitY shall be the Nodal Ministry to monitor the implementation of the Electronic Products Notification.

12. In case of a question whether an item being procured is an electronic product to be covered under the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017, the matter would be referred to the Ministry of Electronics and Information Technology for clarification.

SAURABH GAUR, Jt. Secy.

Annexure

Indicative List of Mechanics and Die Cut Parts

A. Mechanics

1. Battery Cover (HS 39209999)
2. Front Cover (HS 39209999)
3. Front Cover (With Zinc Casting) (HS 39209999)
4. Middle Cover (HS 39209999)
5. GSM Antenna/ Antenna of any technology (HS 39209999)
6. Side Key (HS 85389000)
7. Main Lens (HS 39209999)
8. Camera Lens (HS 39209999)
9. Screw (HS 73181500)
10. Mic Rubber Case (HS 40169990)
11. Sensor Rubber Case/ Sealing Gasket including sealing gaskets/ cases from Rubbers like SBR, EPDM, CR, CS, Silicone and all other individual rubbers or combination/ combinations of rubbers (HS 40 169990)
 - 11.1 PU Case/ Sealing Gasket (HS 39269091) - Other articles of Polyurethane foam like sealing gaskets/ cases.
 - 11.2 Sealing Gaskets/ Cases from PE, PP, EPS, PC and all other individual polymers or combination/ combinations of polymers (HS 39269099)
12. SIM Socket/ Other Mechanical items (Metal) (HS 73269099)
13. SIM Socket/ Other Mechanical items (Plastic) (HS 39269099)
14. Back Cover (HS 39209999)

B. Die Cut Parts

1. Conductive Cloth (HS 39269099)
2. Heat Dissipation Sticker Battery Cover (HS 39199090)
3. Sticker-Battery Slot (HS 39199090)
4. Protective Film for Main Lens (HS 39199090)
5. Mylar for LCD FPC (HS 39199090)
6. LCD Conductive Foam (HS 39269099)
7. Film-Front Flash (HS 39199090)
8. LCD Foam (HS 39269099)
9. BT Foam (HS 39269099)